

レーザ加工技術導入のすすめ

～ 加工の基礎から最新トレンドまで ～

光をツールとし非接触でクリーンな加工を実現するレーザ加工は、カーボンニュートラル実現に適した加工技術の一つとして期待されていますが、中々導入に踏み切れないという方が多いのではないのでしょうか。年々レーザ加工機は高出力化・高安定化・低価格化が進んでおり、これまでの機械加工では困難であった加工を実現する可能性を秘めています。そこで今回の研究会ではレーザ加工技術導入の一助となればと思ひ企画いたしました。はじめにレーザ加工の基礎をご講演いただき、最近のトレンドである xEV、ダイヤモンド、金属 3D プリンタに関連した最新のレーザ加工技術をご講演いただきます。

主催：公益社団法人砥粒加工学会 次世代固定砥粒加工プロセス専門委員会

日時：2023 年 10 月 20 日（金） 13:00～17:00

開催方式：下記会場（対面）と Cisco Webex Meeting（Web）のハイブリッド形式で開催します。

日本大学 理工学部 駿河台キャンパス 1 号館 3 階 134 教室

URL：<https://www.cst.nihon-u.ac.jp/campus/surugadai/>

※ 講演者には開催前の状況により、対面か Web のどちらでの講演かを選択して頂きます。

※ Web 開催に関する詳細情報は、参加ご希望の方に後日通知いたします。



13:00～13:05	開会挨拶	委員長 日本大学 山田 高三 氏
13:05～13:55	講演1 レーザ加工で進める工法転換～生産性向上のコツとノウハウ～	愛知工業大学 金岡 優 氏
13:55～14:45	講演2 Blue-IR ハイブリッドレーザ～xEV に対する銅レーザ溶接技術～	古河電気工業 酒井 俊明 氏
14:45～15:05	<休憩>	
15:05～15:55	講演3 ダイヤモンド工具の新たなステージを切り拓くフェムト秒レーザ加工	ROLLOMATIC Sven Peter 氏
15:55～16:45	講演4 レーザ金属 3D プリンタの最新技術動向	愛知産業 木寺 正晃 氏
16:45～16:50	閉会挨拶・事務連絡	
17:10～19:10	技術交流会	

参加費：研究会：当専門委員会会員：無料，非会員：15,400 円（税抜額 14,000 円＋消費税 1,400 円）

※会員は 5 人／社まで、非会員は 2 人／社まで研究会に参加できます。

技術交流会：会員資格に関わらず 2 名／社まで参加できます。3 人目からは 4,950 円／人（税抜額 4,500 円＋消費税 450 円）を徴収します。

（注）「会員」とは専門委員会会員を指します。学会員ではございませんのでご注意ください。

申込締切日：2023 年 10 月 5 日(木)

（注）当日キャンセルの非会員には、すでに準備に費用がかかっているため参加費を請求致します。

問合せ/申込先：当専門委員会事務局 田附宙美宛

・FAX：048-858-3709, E-mail：sf-office@mech.saitama-u.ac.jp

・申し込みはホームページよりお願いいたします。→<https://jsat-sf.jp/event.html>